

고연성 무전해 Ni-P 도금액 개발
Developed high ductility electroless nickel plating solution

이성준*, Nguyen Van Phuong, 박준영, 서홍식, 김동현
주식회사엠에스씨(E-mail:flipchip@naver.com)

초 록 : 본 연구는 무전해 니켈 도금 공정에서 고연성을 요구하는 Flexible 기판상에 많이 사용되어지고 있는 무전해 니켈 도금액 평가에 관한 것이다. 무전해 도금을 이용하여 도금된 표면은 다양한 패키징 분야에서의 높은 밀도를 가지는 초소형 소자 등의 실장 표면이나 접합 계면으로 사용되고 있는 등 부품 소재 산업에서의 중요성이 점차 증가되고 있다. 고연성 무전해 Ni-P 도금액개발을 통하여 얻고자하는 기술적 과제는 도금층에 높은 연성을 제공하고 안정성이 향상된 무전해 니켈 도금액을 제공하는 것이다.